



Tagesordnung

Thema: 65. Treffen des Arbeitskreises
„Systemzuverlässigkeit von Aufbau- und
Verbindungstechnologien“

Datum: **13. Februar 2019, 10.00 Uhr**

Ort: Fraunhofer IZM, Berlin

Teilnehmer: AK-Mitglieder, Referenten

Tagesordnungspunkte

- 1 10:00 Uhr
Begrüßung, Erläuterung zur Tagesordnung
Herr Wüst, Fraunhofer IZM, Berlin
- 2 10:10 Uhr
Surface Insulation Resistance (SIR) Test und Adaption an die Leistungselektronik
Herr Knofe, Siemens, Berlin
- 3 10:50 Uhr
Feuchte und Temperaturlast in optoelektronischen Sensorpackages –
Materialcharakterisierung und FE Analyse mechanischer Spannungen
Herr Huber, ams AG, Premstaetten (AT)
- 4 11:30 Uhr
Einfluss des thermischen Ausdehnungskoeffizienten auf die
Temperaturwechselfestigkeit von Transformatoren und Elektronik-Modulen
Herr Bürger, ELANTAS Europe GmbH, Hamburg
- 5 12:10 Uhr
Mittagessen
- 6 13:10 Uhr
Nanoporöse Goldschichten - Ein alternatives Verbindungsmaterial in der
Aufbau-und Verbindungstechnik
Frau Fröhlich, Fraunhofer IZM, Berlin

Workshop „Schneller und günstiger qualifizieren“

- 7 13:50 Uhr
Anforderungsprofile für den zuverlässigen Entwurf
Herr Straube, Fraunhofer IZM, Berlin
- 8 14:30 Uhr
Kaffeepause
- 9 15:00 Uhr
Workshop
Herr Straube und Herr Marwede, Fraunhofer IZM, Berlin
- 10 16:20 Uhr
Abschlussdiskussion
Herr Wüst, Fraunhofer IZM, Berlin

Ende der Veranstaltung gegen 16:30 Uhr